

1. PLD:可编程逻辑器件, 包括 PROM、PLA、PAL、GAL、FPGA、CPLD 等。
2. EDA:电子设计自动化
3. CAD:计算机辅助设计
4. HDL:硬件描述语言
5. FPGA (Field Programmable Gate Array):现场可编程门阵列, 高密度, 主要由三部分组成: 可配置逻辑块 (CLB), 输入输出模块 (IOB) 和布线通道。
6. CPLD:复杂可编程逻辑器件, 高密度, 可多次编程、改写和擦除。
7. ISP:在系统编程
8. DTL:二极管晶体逻辑电路
9. TTL:逻辑门电路
10. MOS:金属—氧化物—半导体场效应晶体管
11. ASIC:专用型集成电路
12. PROM:可编程 ROM, 低密度, 内部的或阵列可编程, 与阵列和输出电路固定, 其编程数据只能写一次。
13. PLA:可编程逻辑阵列, 低密度, 内部的或阵列和与阵列可编程, 输出电路固定, 其编程数据只能写一次。
14. PAL:可编程阵列逻辑, 低密度, 内部的与阵列可编程, 或阵列和输出电路固定, 其编程数据只能写一次。
15. GAL:通用阵列逻辑, 低密度, 采用电可擦除的 E²CMOS 工艺。
16. OLMC:输出逻辑宏单元
17. LAB:逻辑阵列块
18. EPT:扩展乘积项
19. PIA:可编程阵列连线
20. IOC:输入输出控制块
21. PSM:可编程开关矩阵
22. PI:可编程互连线
23. CLB:可配置逻辑块
24. RTL:寄存器转换级电路